

# Innovative Halbleiter-Lösungen für mehr **Energieeffizienz, Mobilität** und **Sicherheit**



Unternehmenspräsentation

28. Juli 2011



# Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im dritten Quartal GJ 2011

- Zielmärkte

- Divisionen, Produkte und Technologien

- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Inhalt

- Markt- und Geschäftsentwicklung im dritten Quartal GJ 2011

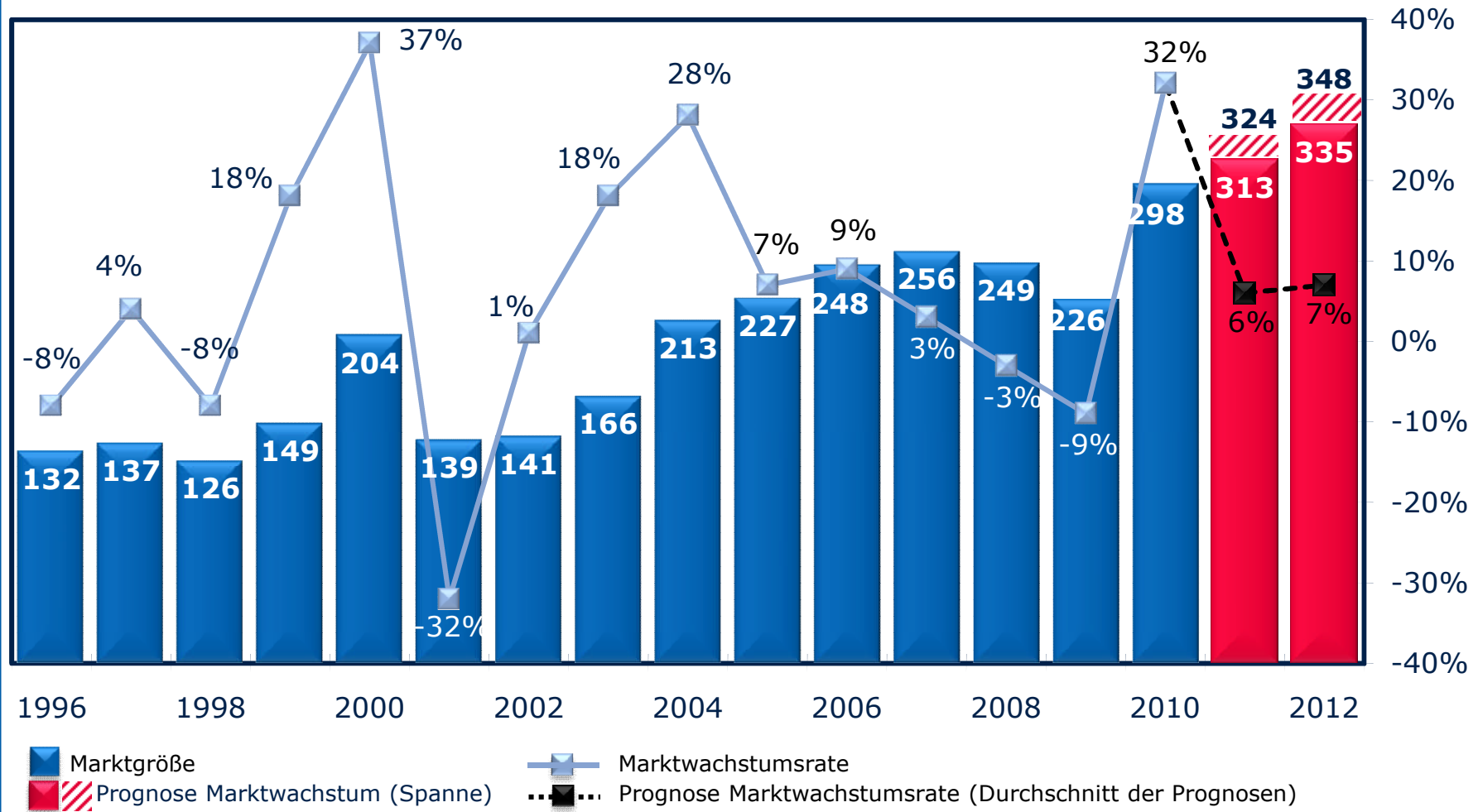
- Zielmärkte

- Divisionen, Produkte und Technologien

- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Entwicklung des globalen Halbleitermarkts

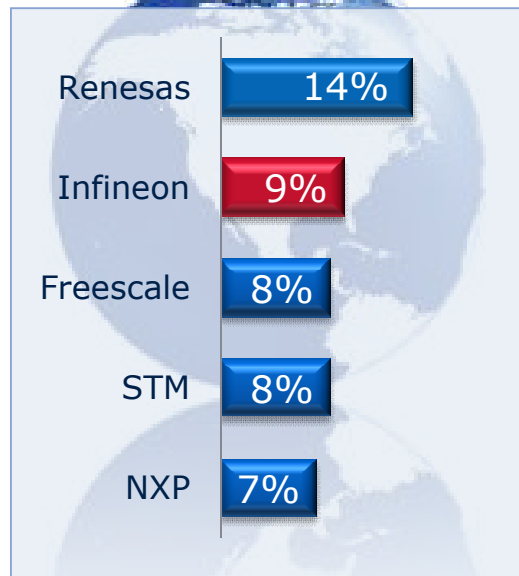
## Marktgröße in Milliarden US-Dollar und Marktwachstumsrate



# Infineon hält Topposition in allen Zielmärkten

## Automotive

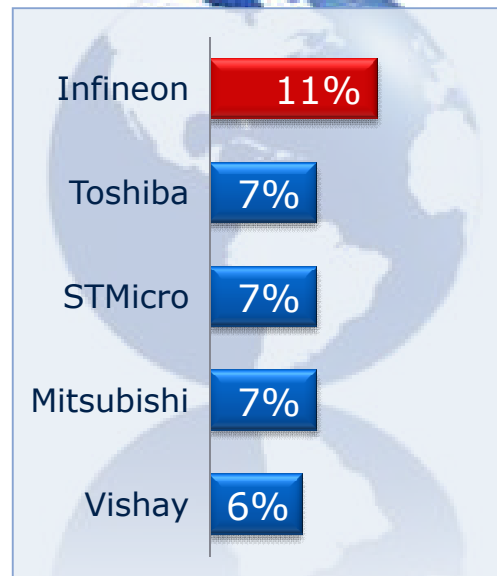
#2



Kalendar Jahr 2010.  
Quelle: Strategy Analytics, April 2011

## Power

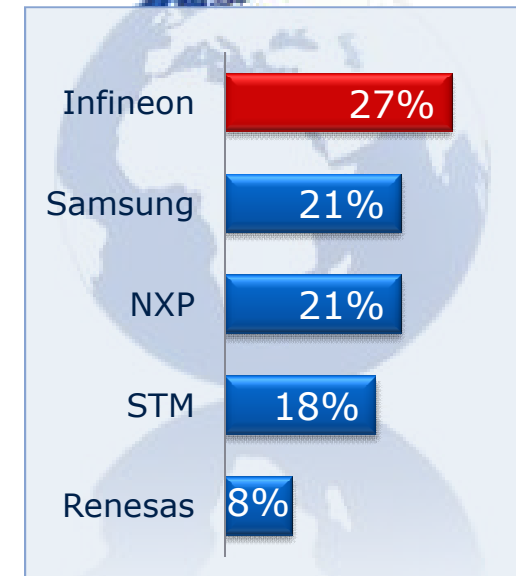
#1



Kalendar Jahr 2010.  
Quelle: IMS Research, August 2011

## Chip Card

#1



Kalendar Jahr 2010.  
Quelle: IMS Research, Juli 2011.

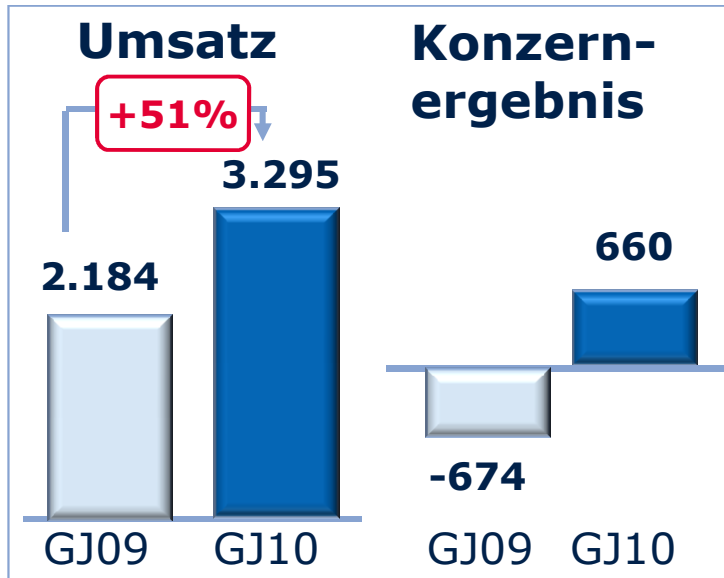
## Das Unternehmen

- Infineon adressiert mit seinen Halbleiter- und Systemlösungen die zentralen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft: **Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit**
- Umsatz im Geschäftsjahr 2010\*: 3,295 Mrd. EUR
- 25.149 Mitarbeiter weltweit (Stand: Juli 2011)
- Starkes Technologieportfolio mit ca. **15.400** Patenten und Patentanmeldungen (Stand: Februar 2011)
- Über **20 F&E-Standorte**
- Deutschlands größtes und Europas zweitgrößtes Halbleiterunternehmen

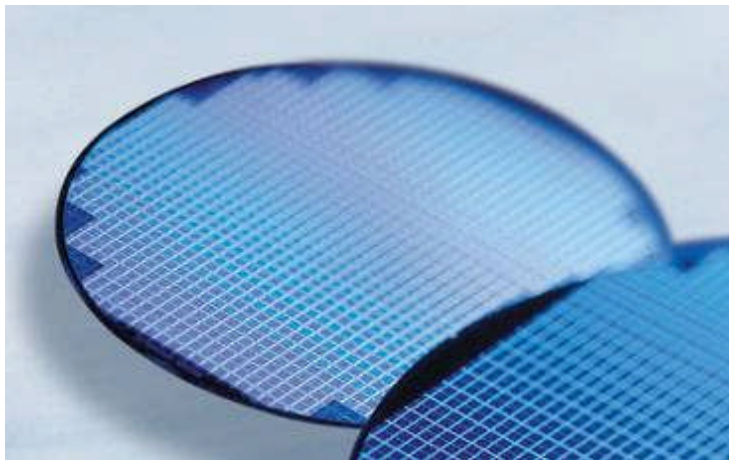
\*Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich der Wireline- und Wireless-Sparten als nicht fortgeführte Aktivitäten;  
Stand: 30. September 2010

# Infineon-Konzern

## Ergebnisse GJ 2009 und GJ 2010



[Mio. Euro]	2009	2010
Umsatz	2.184	3.295
Segmentergebnis	-140	475
Segmenterg. Marge	-6,4%	14,4%
Konzernergebnis	-674	660

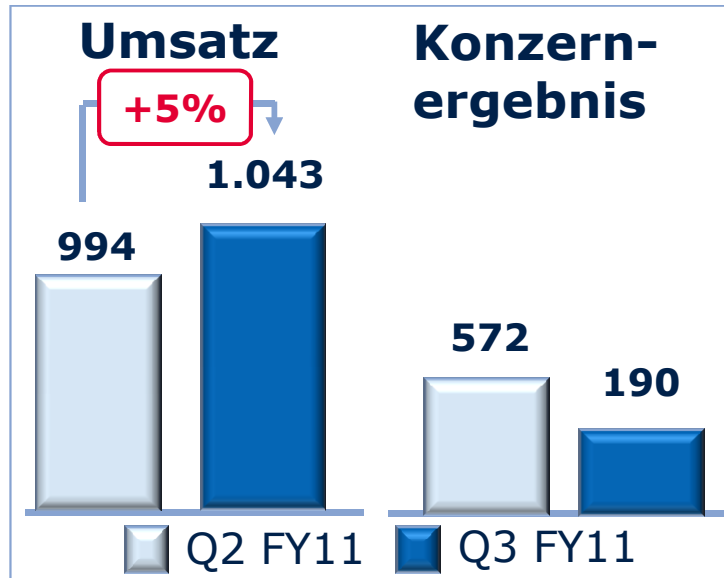


Free-Cash-Flow	274	573
Investitionen (Sachanl.)	96	292
Netto-Cash	657	1.331
Marktkapitalisierung	~4.200	~5.522

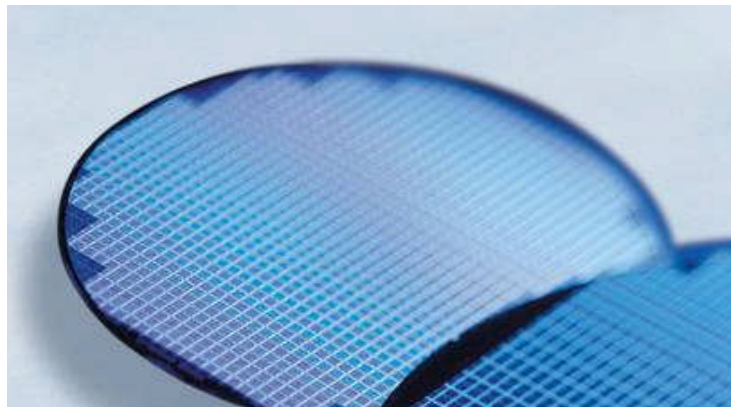


# Infineon-Konzern

## Ergebnisse Q3 GJ 2011 und Q2 GJ 2011



in € million	Q2 11	Q3 11
Revenues	994	1.043
Segment Result	202	212
SR Margin	20%	20%
Net result	572*	190



Free Cash Flow	13	-8
Gross Cash Position	2.691	2.585
Net cash	2.335	2.246

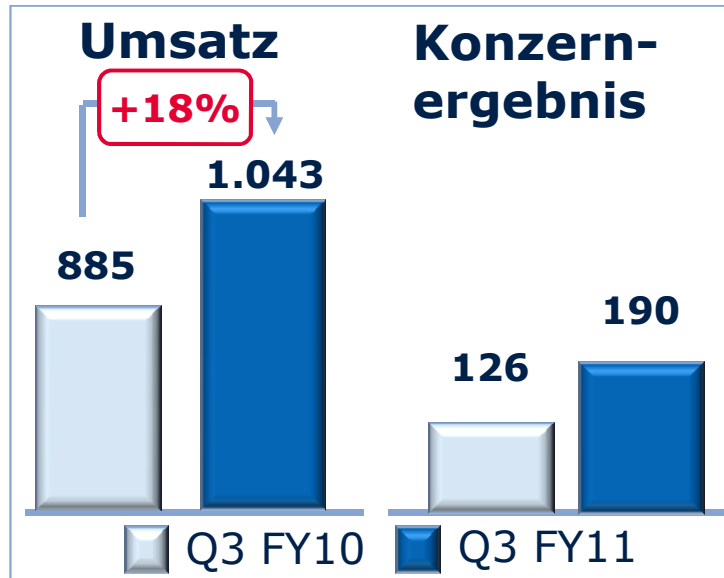
Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten

\*: Beinhaltet den Verkauf von Wireless an Intel

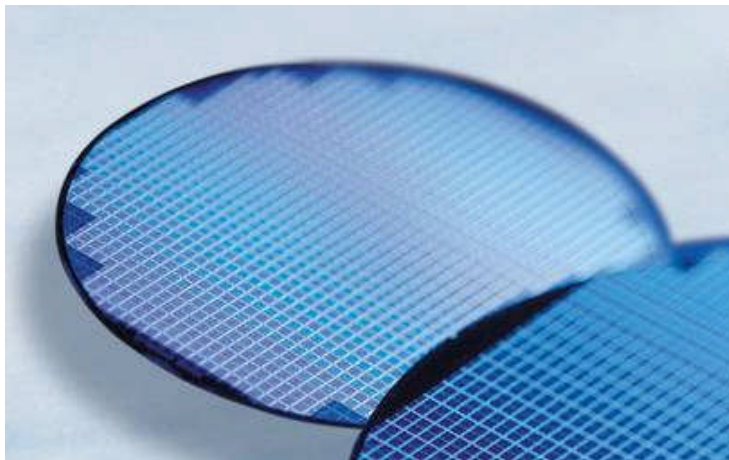


# Infineon-Konzern

## Ergebnisse Q3 GJ 2010 und Q3 GJ 2011



in € million	Q3 10	Q3 11	
Revenues	885	1.043	➔
Segment Result	138	212	➔
SR Margin	16%	20%	➔
Net result	126	190	➔
Free Cash Flow	173	-8	➔
Gross Cash Position	1.514	2.585	➔
Net cash	1.108	2.246	➔

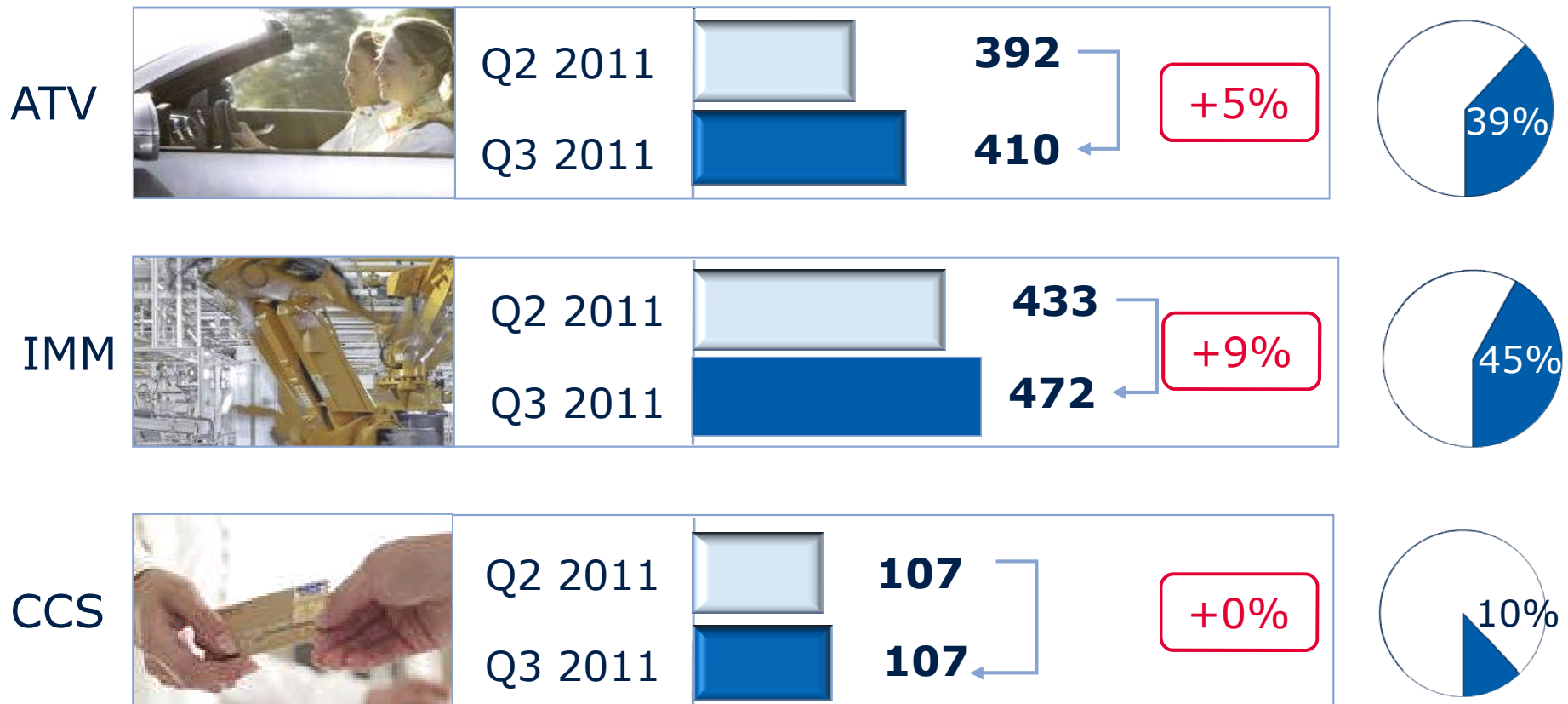


Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten

# Umsatzerlöse nach Segmenten Q2 GJ 2011 und Q3 GJ 2011



**Umsatz\* in Mio. Euro** **Anteil am Gesamtumsatz**



\* Im Gesamtumsatz (Q2 GJ11: 994 Mio €; Q3 GJ11: 1.043 Mio €) enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q2 GJ11: 61 Mio. €, Q3 GJ11: 54 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q2 GJ11: 1 Mio. €, Q3 GJ11: 0 Mio. €).

# Ergebnisse nach Segmenten Q2 GJ 2011 und Q3 GJ 2011

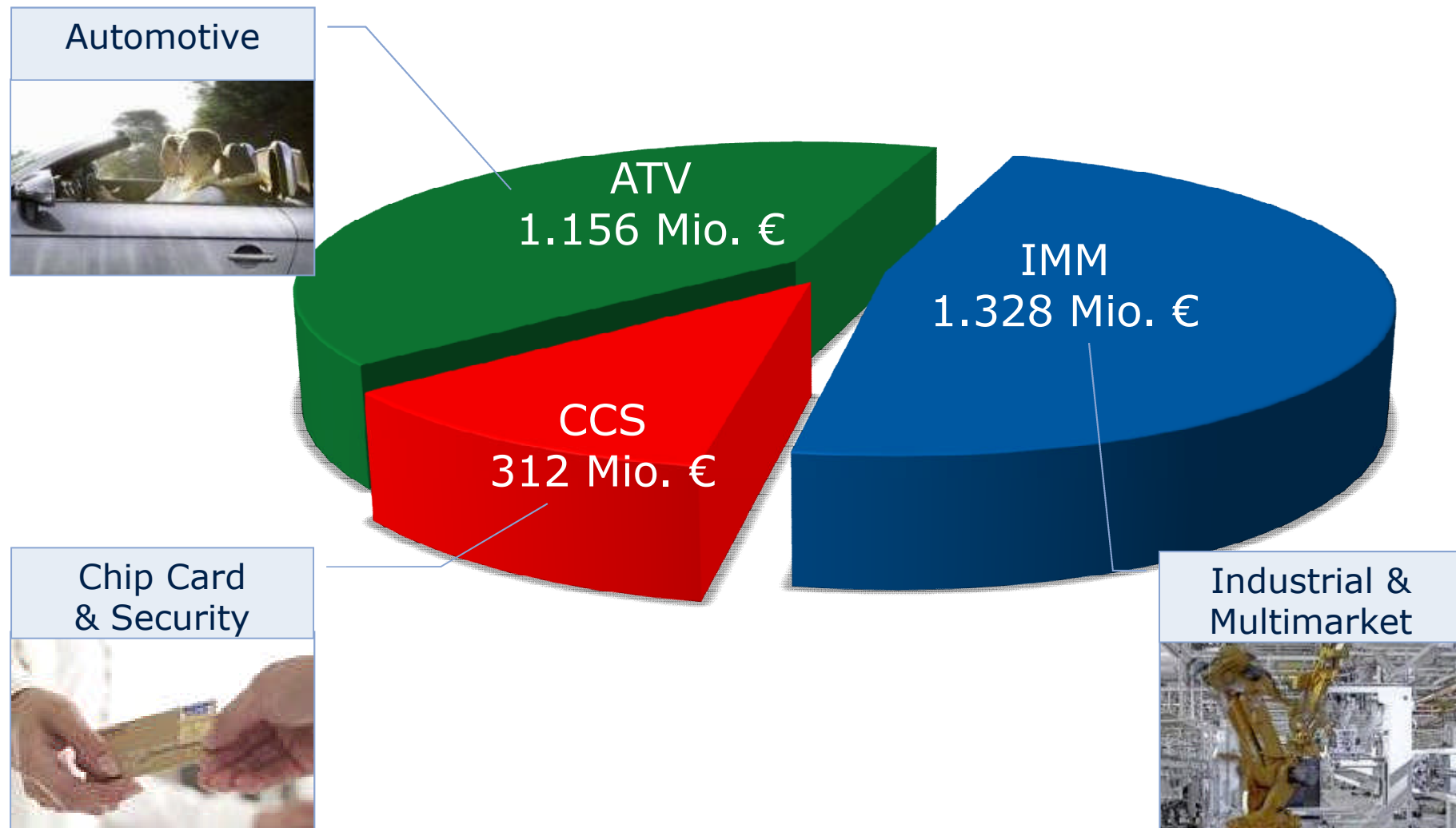


Segmentergebnis* in Mio. Euro				Marge
ATV		Q2 2011	<b>74</b>	19%
		Q3 2011	<b>80</b>	20%
IMM		Q2 2011	<b>108</b>	25%
		Q3 2011	<b>116</b>	25%
CCS		Q2 2011	<b>14</b>	13%
		Q3 2011	<b>14</b>	13%

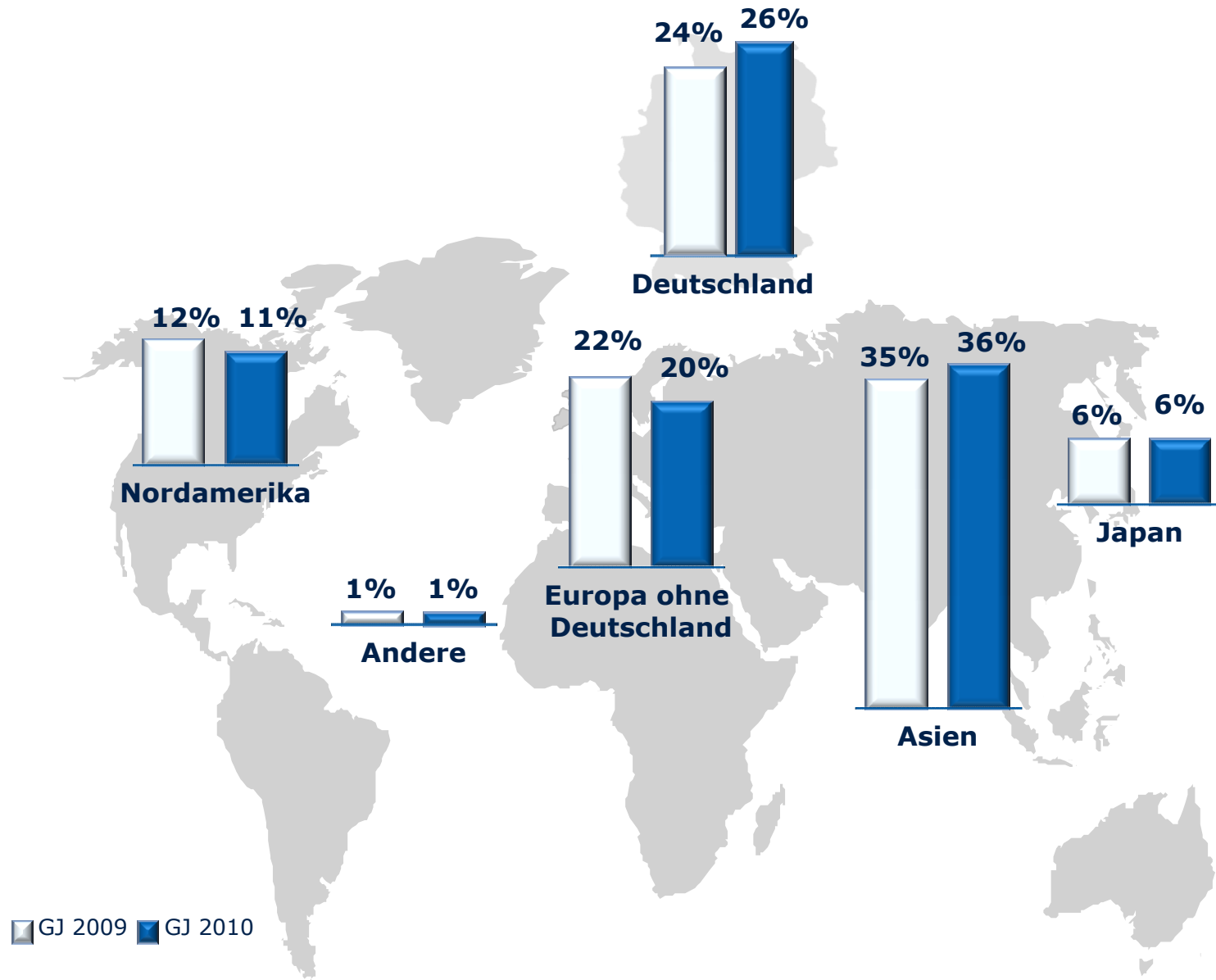
\* Im Gesamtsegmentergebnis (Q2 GJ11: 202 Mio €; Q3 GJ11: 212 Mio €) enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q2 GJ11: 7 Mio. €, Q3 GJ11: 3 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q2 GJ11: -1 Mio. €, Q3 GJ11: -1 Mio. €).

# Umsatz nach Divisionen

## Umsatzverteilung ersten drei Quartale GJ 2011



# Umsatz nach Regionen GJ 2009 und GJ 2010



■ GJ 2009 ■ GJ 2010

# Inhalt

■ Markt- und Geschäftsentwicklung im dritten Quartal GJ 2011

■ Zielmärkte

■ Divisionen, Produkte und Technologien

■ Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Infineon Compass - Kurzfassung

## Unsere Bestimmung

Wir sind der Innovationsführer bei Halbleitern für Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Unsere Lösungen unterstützen moderne Gesellschaften zu wachsen und schützen zugleich die Umwelt.

## Unser Weg

Unsere Mitarbeiter sind die Basis der einzigartigen Wettbewerbsvorteile, guter finanzieller Ergebnisse und Höchstleistungen von Infineon. Wir wollen unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären das Beste bieten – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

## Unsere Werte

Vier Grundwerte sind der Antrieb in unserer täglichen Arbeit:  
We commit (Wir handeln engagiert und verbindlich) – We innovate (Wir sind innovativ) – We partner (Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen) – We perform (Wir bringen Leistung).



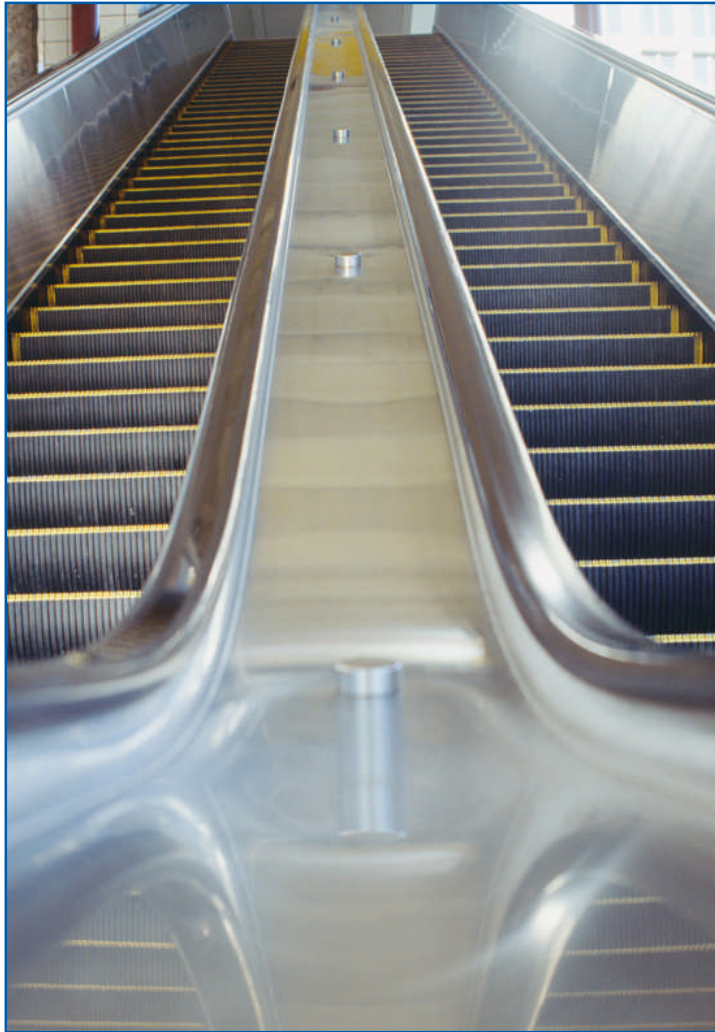
Photos: helgahengge.com

28.07.2011

# Infineon Compass



# Auf dem Weg zu einem High-Performance-Unternehmen



- Erfolgreiche Umstrukturierung dank IFX10+
  - Konsequente Kostenreduzierung
  - Effizienzsteigerung
- Erfolgreiche Refinanzierung 2009
  - Rückkauf und Tilgung nachrangiger Umtausch- und Wandelanleihen 2009 (Gesamt: 367 Mio. Euro nominal)
  - Ausgabe einer neuen nachrangigen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014, Bruttoertrag ca. 182 Mio. Euro
  - Kapitalerhöhung um 674 Mio. €, zu 100% gezeichnet
  - Striktes Working-Capital-Management, Investitionsdisziplin
- Konsequente Ausrichtung des Infineon-Portfolios an den Zielmärkten
  - Weltweit führend in den Segmenten ATV, IMM und CCS
  - Verkauf von WLC an Golden Gate Capital
  - Verkauf von WLS an Intel
  - Klare Ausrichtung auf drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft:
    - ↪ Energieeffizienz
    - ↪ Mobilität
    - ↪ Sicherheit

# Wir konzentrieren uns auf unsere Zielmärkte



## Fokusthemen

- Energieeffizienz
- Mobilität
- Sicherheit

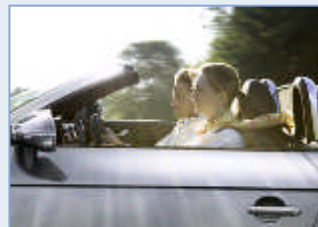


## Kernkompetenzen

- Analog- und Mixed-Signal-Schaltungen
- Leistungshalbleiter
- Embedded Control
- Fertigungskompetenz

## Unsere Zielmärkte

- Automotive
- Industrial & Multimarket
- Chip Card & Security



# Fokussierung auf drei Bereiche mit hervorragenden Zukunftsperspektiven



## Energieeffizienz



## Mobilität



## Sicherheit



**Automotive**

**Industrial & Multimarket**

**Chip Card & Security**

Maßgebliche Faktoren für die Einführung des neuen Fokusbereichs „Mobilität“:

- Unsere Marktführerschaft im Automotive-Sektor
- Wachsende Bedeutung neuer Mobilitätskonzepte (z.B. Elektromobilität) und
- Innovative Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr (Antriebe, elektronische Fahrscheine)

# Energieeffizienz



## Wichtige Trends

- Dem dramatisch steigenden weltweiten Energiebedarf stehen schwindende Ressourcen fossiler Energieträger gegenüber
- Strenge CO<sub>2</sub>-Richtlinien sollen das Erreichen von Klimazielen sichern
- Erneuerbare Energien werden vermehrt als nachhaltige Ressourcen genutzt
- Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen

## Unser Beitrag

- Unsere innovativen Halbleiterlösungen spielen eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Leistungsverlusten und steigern die Effizienz der gesamten Energie-Versorgungskette – von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Nutzung.
- Unsere Produkte bilden die Grundlage für die intelligente und optimale Nutzung von Energieressourcen in der Industrie, in Privathaushalten und in Fahrzeugen.



## Wichtige Trends

- Strenge CO<sub>2</sub>-Richtlinien und steigender Ölpreis
- Neue Sicherheitsvorschriften für die Unfallprävention
- Wachsender Markt für preiswerte Fahrzeuge in Schwellenländern
- Urbanisierung, Globalisierung und demografische Veränderungen
- Große Investitionen in öffentlichen Nah- und Fernverkehr

## Unser Beitrag

- Unsere führenden Halbleiterlösungen ermöglichen eine nachhaltige Mobilität, indem sie dazu beitragen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Anschaffungskosten zu senken.
- Als Innovationsmotor und Anbieter von Schlüsselkomponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird Infineon auch weiter den Wandel in Richtung Elektromobilität mitgestalten.
- Innovative Lösungen für Antriebe und elektronische Tickets im öffentlichen Personenverkehr.



# Sicherheit



## Wichtige Trends

- Bedarf an sicheren Systemen in allen Bereichen des Lebens
- Sichere Kommunikation überall – mit Mobiltelefon und mobilem Internet
- Einführung von elektronischen Ausweisen und Produktkennzeichen
- Zahlungssysteme mit kontaktlosen Karten und elektronische Tickets
- Zunehmender Einsatz von Elektronik im Auto erfordert sicheres Datenmanagement

## Unser Beitrag

- Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für alle Systemanforderungen ermöglichen die Implementierung transparenter Sicherheitsfunktionen in Standardsystemen.
- Sicherheitsanwendungen in der Industrie und im Automobilsektor profitieren von unserer globalen Kompetenz im Bereich Smartcards.
- Unsere Produkte verbinden Hardware-Sicherheit und Verschlüsselung und bilden damit die Grundlage für Vertraulichkeit und Sicherheit sowie erweiterte Kommunikationsfunktionen, ohne die persönliche Freiheit einzuschränken.

# Wir orientieren uns an unseren Kunden





# Inhalt

■ Markt- und Geschäftsentwicklung im dritten Quartal GJ 2011

■ Zielmärkte

■ **Divisionen, Produkte und Technologien**

■ Allgemeine Informationen zum Unternehmen

# Infineon – Marktorientierte Geschäftsstruktur



## Divisionen

## Kernanwendungen



# Eine neue Ära: Mehrere Faktoren sorgen für eine steigende Nachfrage im Bereich der Leistungshalbleiter



'90 – '10



'10 – '30



## Veränderungen



- Der Wandel in Richtung erneuerbare Energien erfordert deutlich mehr Hochleistungshalbleiter pro MW generiertem Strom.

- Eine effizientere Stromwandlung sorgt für einen niedrigeren CO<sub>2</sub>-Ausstoß und verringert die Material- und Elektrizitätskosten.



- Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs sorgt für einen höheren Bedarf an Hochleistungshalbleitern in Automobilen und verdoppelt die Chip-Nachfrage.



- Aufgrund des schnell steigenden Lebensstandards in den BRIC-Staaten erhöht sich die Nachfrage nach Leistungshalbleiterprodukten.



## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- **Nachhaltiges Engagement:** über **40 Jahre System- und Anwendungs-Know-how** im Automotive-Bereich
- **Anbieter kompletter Automotive-Systeme**
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** branchenweit **führend bei Know-how** und Produktportfolio
- **Weltweite** Entwicklungs-, Fertigungs- und Support-Standorte für Automotive-Halbleiter
- **Automotive Excellence:** umfangreichstes Qualitätsprogramm in der Halbleiterbranche

## Produktpalette

- **Sensorik:** Druck-, Temperatur-, Magnetsensoren; Wireless Control-ICs, Radar
- **Mikrocontroller:** 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit
- **Leistungshalbleiter:** MOSFETs, IGBTs, intelligente Leistungs-ICs: Spannungsregler, Brücken, Treiber-ICs, CAN/LIN/FlexRay™-Transceiver, DC/DC-Wandler, Stromversorgungs-ICs, SoC Embedded Power-ICs
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** HybridPACK™-Module, Automotive Easy-Module, Gate-Treiber-ICs, MOSFETs, IGBTs

## Marktposition

- **Nr. 2** bei Automotive-Halbleitern weltweit
- **Nr. 1** in Europa
- **Nr. 2** in der NAFTA-Region
- **Nr. 4** in der übrigen Welt

Quelle: Strategy Analytics (April 2011)

\* FlexRay ist eine Marke der FlexRay Consortium GbR und wird unter Lizenz verwendet



# Fokus auf Zukunftstechnologien

## Beispiel 1: Umweltfreundliche Autos



### Markttrends

- Knapper werdende Energieressourcen
- Strengere Vorgaben zum CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Wachsendes Umweltbewusstsein

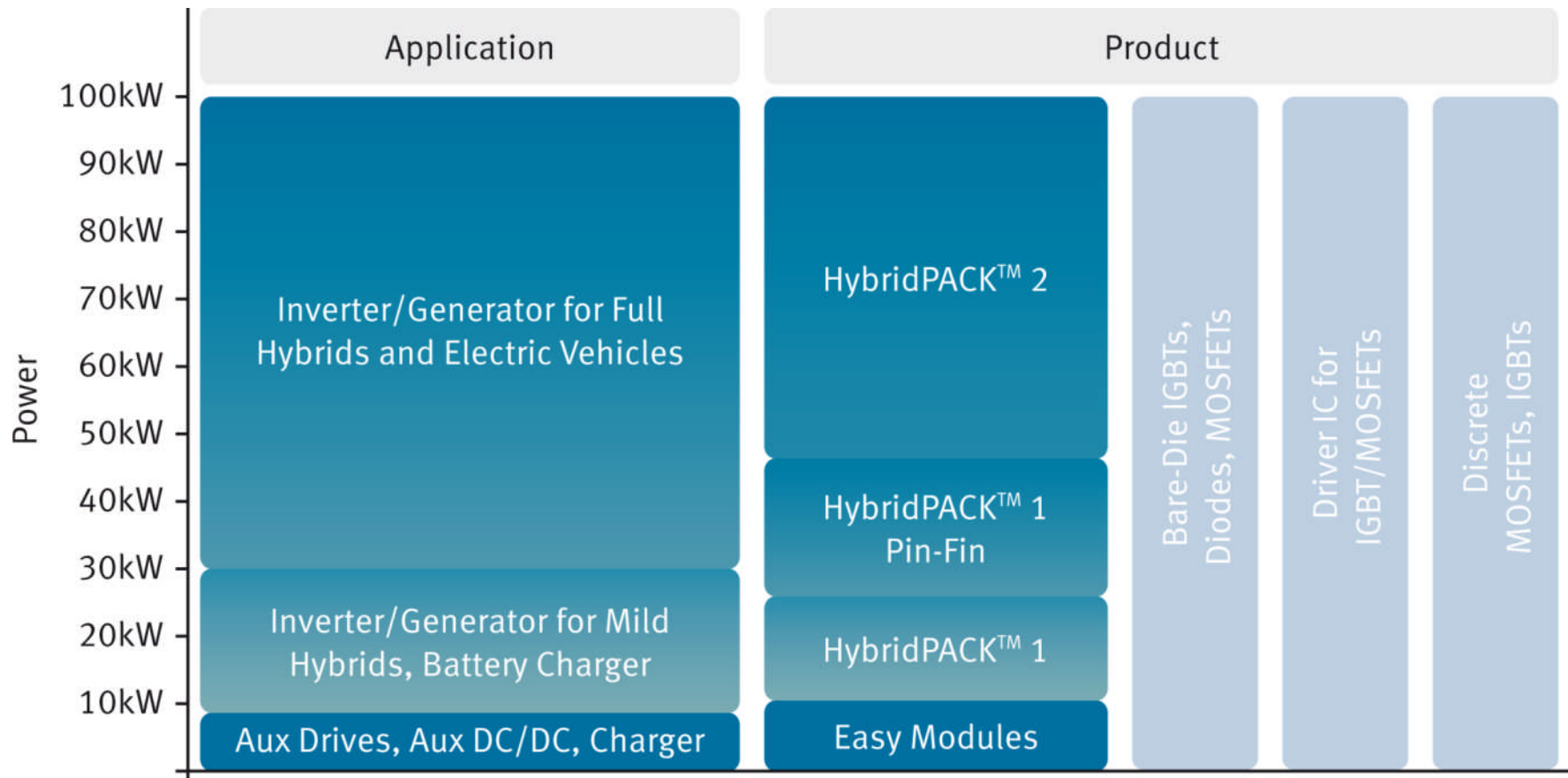
### Chancen für Infineon

- Infineon-Bausteine ermöglichen eine erhebliche CO<sub>2</sub>-Reduzierung um insgesamt ~23 g/km
- Wir bieten Produkte für den Antriebsstrang von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HybridPACK™)
- Halbleiter machen Elektroautos überhaupt erst möglich (elektrische Antriebe/ Steuerungen, Batteriemanagement, integrierte Batterieladefunktionen und Fahrzeugnetzkommunikation)

Hinweis: CO<sub>2</sub>-Reduzierung bei EU-Durchschnittsautos: 170 g/km



# Zielanwendungen für die Elektrifizierung des Antriebsstrangs – Produktportfolio





## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- Hochwertige Produkte und Services
- Führendes Technologie- und IP-Portfolio
- System-Know-how und umfassendes Anwendungswissen
- Starke weltweite Präsenz mit Standorten für lokale Vertriebs- und Anwendungsunterstützung
- Dedizierte Kundenbetreuungsteams und Distributoren

## Produktpalette

- Diskrete Leistungshalbleiter, Leistungsmodule und Power Stacks
- Stromversorgungs-ICs
- NF/HF-Dioden und -Transistoren, HF-Leistungsverstärker
- Silizium-MEMS-Mikrofone, TVS-Dioden
- LED-Treiber
- ASIC-Lösungen einschließlich Sicherheits-ASICs für Authentifizierungs- und Markenschutzanwendungen
- Mikrocontroller: 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit

## Marktposition

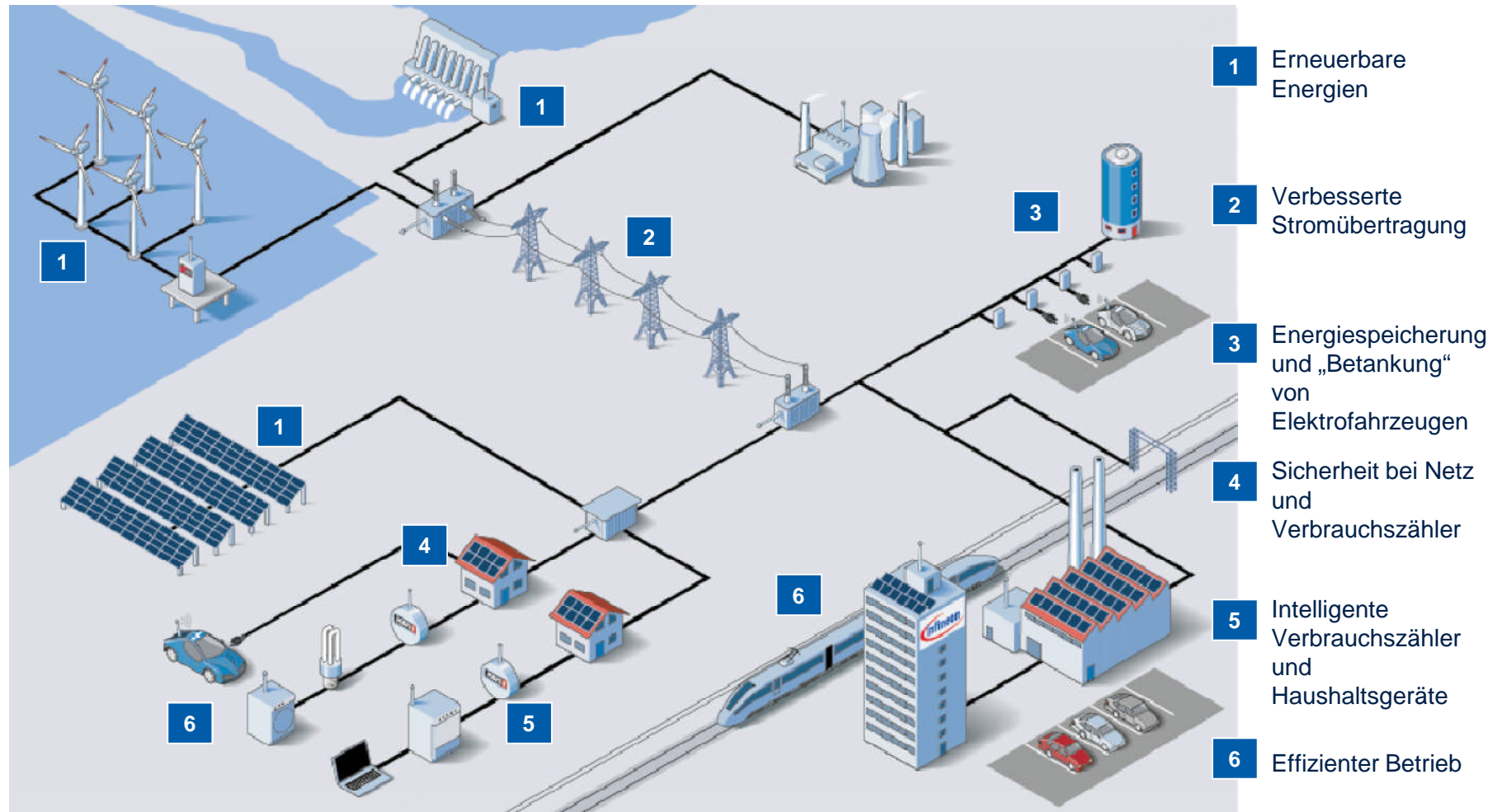
- Nr.1 bei Leistungshalbleitern acht Jahre in Folge
  - Nr.2 bei Leistungsmodulen mit 20,4% Marktanteil
  - Nr.1 bei diskreten Leistungshalbleitern mit 8,6% Marktanteil

Quelle: IMS Research, August 2011



# Fokus auf Zukunftstechnologien

## Beispiel 2: Smart Grid



# Leistungskomponenten für die Antriebssteuerung bei Zugsystemen



## Hochgeschwindigkeitszüge



## U-Bahnen



## Infineon-Komponenten

- Leistung: 5 bis 10MW pro Zug
- 80 bis 120 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:  
~100.000 EUR pro Zug



- Leistung: 0,5 bis 1MW pro Zug
- 25 bis 50 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:  
~10.000 EUR pro Zug

# Chip Card & Security Überblick



## Produktpalette

- Kontaktlose und kontaktbasierte Sicherheitsprodukte für Kommunikation, Zahlungsverkehr, amtliche Ausweise, Personen- und Objektidentifikation, Unterhaltung und Plattformensicherheit
- Umfassendes Packaging- und Serviceangebot
- Innovative Lösungen von einfachen Sicherheits-RFID- und Speicheranwendungen bis hin zu High-End-Sicherheitscontrollern (z.B. die preisgekrönte SLE 78-Familie)

## Kernkompetenzen/ Value Proposition

- Tailored Security: maßgeschneiderte Sicherheit mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Contactless Excellence: Schwerpunkt auf Interoperabilität und Dual Interface
- Embedded Control: ausgewogenes Verhältnis von Rechenleistung, Stromverbrauch, Sicherheitsniveau und Kosten

## Marktposition

- Nr. 1 auf dem Chipkarten-IC-Markt seit 14 Jahren mit Marktanteil von 27%<sup>1</sup> nach Umsatz
- Marktführer bei behördlichen Ausweisen und Zahlungsanwendungen<sup>2</sup> und Trusted Platform Modules
- Etwa die Hälfte aller 2010 ausgestellten behördlichen Ausweise verwenden Sicherheitschips von Infineon (ohne Berücksichtigung von China)
- Infineon liefert die Chips für das europaweit größte Ausweisprojekt, den neuen deutschen elektronischen Personalausweis (nPA)

# Konzentration auf Zukunftstechnologien

## Beispiel 3: Datenschutz

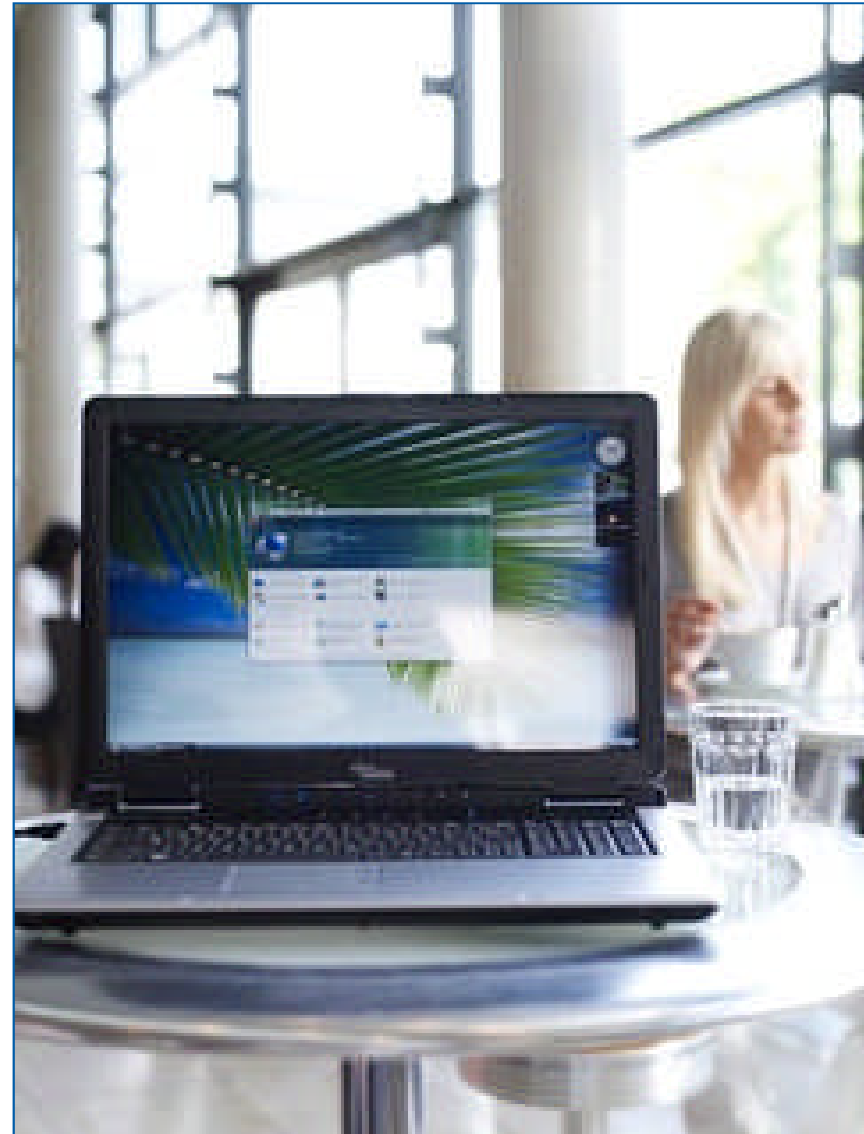


### Markttrends

- TPM (Trusted Platform Module)-Chips in 70% aller Firmen-Notebooks und -PCs; Windows 7-Unterstützung
- Datenschutz: Verschlüsselung von Dateien, Ordnern, Festplatten, Nachrichten und digitalen Signaturen
- Starke Authentifizierung: Netzwerkzugangsschutz und zusätzlicher Authentifizierungsfaktor

### Chancen für Infineon

- Marktführer bei TPM-Lösungen
- TPM-Sicherheitschips von Infineon erhielten als erste die weltweite TCG- und Common Criteria-Zertifizierung und sind von der britischen Regierung für sicherheitskritische Anwendungen zugelassen





# Infineons SLE 78-Sicherheitscontroller im neuen elektronischen Personalausweis (nPA)



## Der neue elektronische Personalausweis in Deutschland

- Projektstart Nov. 2010
- Europaweit größtes Ausweisprojekt
- Derzeit ca. 60 Mio. Ausweisinhaber in Deutschland
- Pro Jahr werden in Deutschland ca. 6,5 Mio. Ausweiskarten ausgegeben
- Infineon liefert die Chips für einen Großteil der neuen Ausweise
- Der neue elektronische Personalausweis (nPA) ist als eines der fortschrittlichsten Projekte im Bereich Ausweissicherheit für die beteiligten Technologieanbieter äußerst prestigeträchtig
- ~ 80% der elektronischen Ausweiskarten in Europa enthalten Sicherheits-Mikrocontroller von Infineon



- Der nPA ist das erste große Projekt, in dem die 16-Bit-SLE 78-Controller zum Einsatz kommen
- Die SLE 78-Controller basieren auf der „Integrity Guard“-Technologie



INTEGRITY GUARD

## Die wichtigsten Kunden

### Automotive

- Autoliv
- Bosch
- Continental
- Delphi
- Denso
- Hella
- Hyundai
- Kostal
- Lear
- Mitsubishi
- TRW
- Valeo

### Industrial & Multimarket

- ABB
- Alstom
- Cisco
- Converteam
- Dell
- Delta
- Emerson
- Ericsson
- HP
- LG Electronics
- Microsoft
- Nokia
- Panasonic
- Philips
- RIM
- Samsung
- Schneider Electric
- Siemens
- SMA Technology
- Sony

### Chip Card & Security

- Beijing Watch Data
- Gemalto
- Giesecke & Devrient
- Oberthur
- Sagem Orga
- US Government Printing Office

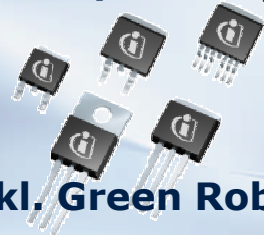
- **Wichtigste Channel-Partner**  
(Distributoren):  
Arrow, Avnet,  
Beijing Jingchuan,  
Rutronik, Tomen,  
Toyotsu,  
WPG Holding
- **Electronic Manufacturing Services (EMS):**  
Celestica,  
Flextronics,  
Foxlink, Hon Hai,  
Jabil, Sanmina-SCI

# Das Halbleitertechnologie-Portfolio von Infineon



## Technologieportfolio für die Anforderungen von Logik- und Leistungsanwendungen

### Power/Analog



inkl. Green Robust

**Analog Bipolar:** DOPL, Ax, BIPEP, B4C  
**Analog BICMOS:** B6CA, B6CA-CT, B7CA, SPT170  
 500 - 350nm HV-CMOS-SOI  
**Smart Power :** 1200-130nm BIP/CMOS/DMOS  
 SPTx (Automotive, EDP) (BCD)  
**Smart :** CMOS/DMOS, SMARTx,  
 (SmartMOS) MSMARTx, SSMARTx Opto-TRIAC  
**DMOS:** Low Voltage Trench  
 Mosfets (OptiMOS)  
**HV-DMOS:** Superjunction MosFET  
 (CoolMOS)  
**IGBT:** Trench IGBT 600-6500V, rev.  
 cond., fast recov. diodes  
**SiC:** Diode; MOS/JFET  
**alle Produkte für Automotive- und Industrieanwendungen geeignet**

### MEMS/Sensoren



**Analog ICs:** B6CA, B7CA  
 Coreless Transformer  
**Magnet:** BxCAS, C9FLRN\_GMR  
**Opto:** OP-DI, OP-TR, OP-C9N,  $\mu$ -modules  
**Pressure:** BxCSP, TIREPx  
**Silicon-Microphones**

### CMOS



**Digital CMOS:** 800nm - 65nm Technology Nodes (Platform <180nm incl. RF, AMS)  
**Analog/Mixed Signal:** 500nm - 180nm Technology Nodes (CxNA)  
**eNVM:** EEPROM: IMEMR, C9FL, OTP: C5OP (Automotive)  
**eFlash/EEPROM:** 250nm - 65nm CxFL (Chip Card), CxFLA, CxFLN (Automotive)  
**HV-CMOS:** 130nm, C11HV

### RF/Bipolar



**RF BICMOS:** 25GHz - 100GHz: B6HFC, B9COPT, B10C  
**Bipolar IC:** 2GHz...200GHz RF-Bipolar: BxHF  
**HiPAC:** Al/Cu Integrated Passives  
 P7Mxx, P7Dxx, P8Mxx, P9Mxx  
**Bipolar/Discrete Bausteine/MMIC:**  
**RF-Transistoren** NF-TR; BxHF(D/M),  
**Leistungsverst.:** LDMOS, LDxM, LDxIC, LD9AB  
**Dioden:** NF-DI, Tuner: DxT, Schottky: DxS  
**SiGe:** B7HFM, B7HF\_SLC, B7HF200  
**RF Switches:** C7NP, C11NP  
**SiGe:** B7HFD/M, B7HF\_SD  
**RFMOS:** HFM  
**PIN:** DxP



# Das Gehäusetechnologie-Portfolio von Infineon



ICs				Leistungshalbleiter			
Wafer Level Package, Bare Die	Laminat-gehäuse	Leadframe-basierte Gehäuse	Chipkarten	Diskrete Bausteine	Sensoren	High Power	Leistungs- halbleiter
<p><b>Surface Mount Technologie (SMD)</b></p> <p><b>Wafer Level</b> w/o redistribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WLP (fan-in)</li> </ul> <p>w/redistribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WLB (fan-in)</li> <li>▪ eWLB (fan-out)</li> </ul> <p><b>Bare Die</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wirebond</li> <li>▪ Flip chip</li> </ul>	<p><b>SMD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OCCN <sup>1)</sup></li> <li>▪ BGA</li> <li>▪ LBGA</li> <li>▪ xFBGA, xFSGA</li> </ul> <p><b>Flip chip</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FCxBGA</li> <li>▪ xF2BGA, xF2SGA</li> </ul>	<p><b>Through Hole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DIP <sup>2)</sup></li> </ul> <p><b>SMD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PLCC <sup>2)</sup></li> <li>▪ TSSOP</li> <li>▪ TQFP</li> <li>▪ LQFP</li> <li>▪ MQFP</li> </ul> <p><b>Leadless</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VQFN</li> <li>▪ O-LQFN <sup>1)</sup></li> </ul>	<p><b>Mold on LF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P-MCCx</li> </ul> <p><b>Mold</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P-Mx.x</li> </ul> <p><b>Chip on Flex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FTM</li> </ul> <p><b>UV Globe top</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T-Mx.x</li> </ul> <p><b>PRELAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPxx</li> </ul> <p><b>Flip Chip</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S-MFCx.x</li> </ul> <p><b>Wafer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bumped</li> <li>▪ Diced</li> </ul>	<p><b>SMD leaded</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOT</li> <li>▪ SOD</li> </ul> <p><b>Flat lead</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TSFP</li> <li>▪ SC</li> </ul> <p><b>Leadless</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TSLP</li> <li>▪ TSSLP</li> <li>▪ TSNP</li> </ul> <p><b>Wafer level</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WLP</li> </ul>	<p><b>Through Hole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PSSO</li> </ul> <p><b>SMD Leaded</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DSO</li> <li>▪ SC</li> <li>▪ TSOP</li> </ul> <p><b>Open cavity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DSOF</li> </ul>	<p><b>Power Modules</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Easy</li> <li>▪ 62mm</li> <li>▪ Econo</li> <li>▪ Econo PACK+</li> <li>▪ PrimePACK</li> <li>▪ IHM</li> <li>▪ IHV</li> <li>▪ Hybrid PACK</li> </ul>	<p><b>Through Hole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TO, DIP</li> </ul> <p><b>SMD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TO</li> <li>▪ DSO</li> <li>▪ SSOP</li> </ul> <p><b>Leadless</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TDSON</li> <li>▪ TSDSON</li> <li>▪ CanPAK</li> <li>▪ SON</li> <li>▪ QFN</li> </ul> <p><b>SIP Low Power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IDC</li> </ul> <p><b>SIP Medi. Power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIPOS</li> </ul>

1) Nur für Spezialanwendungen 2) Auslauf

# Inhalt

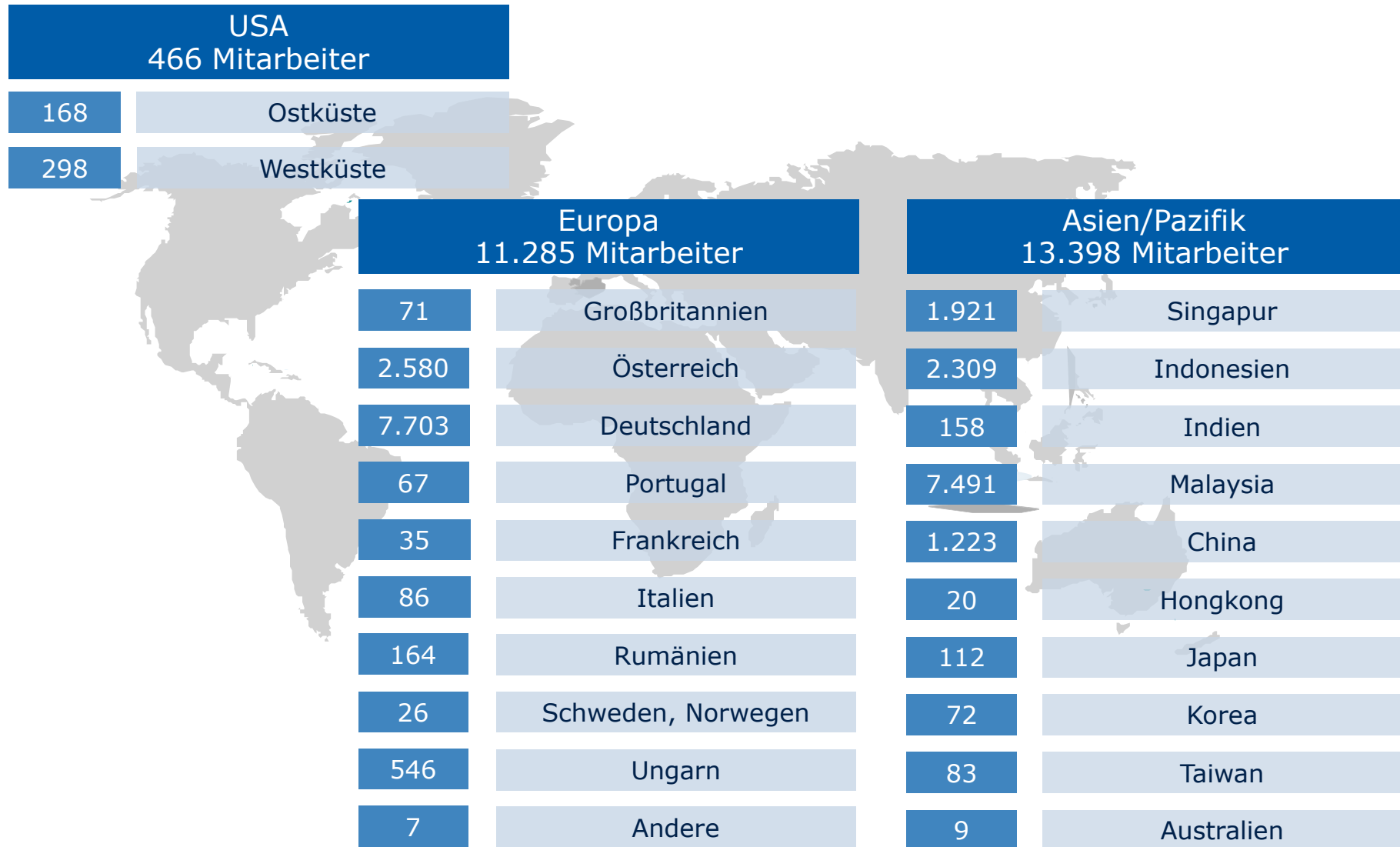
■ Markt- und Geschäftsentwicklung im dritten Quartal GJ 2011

■ Zielmärkte

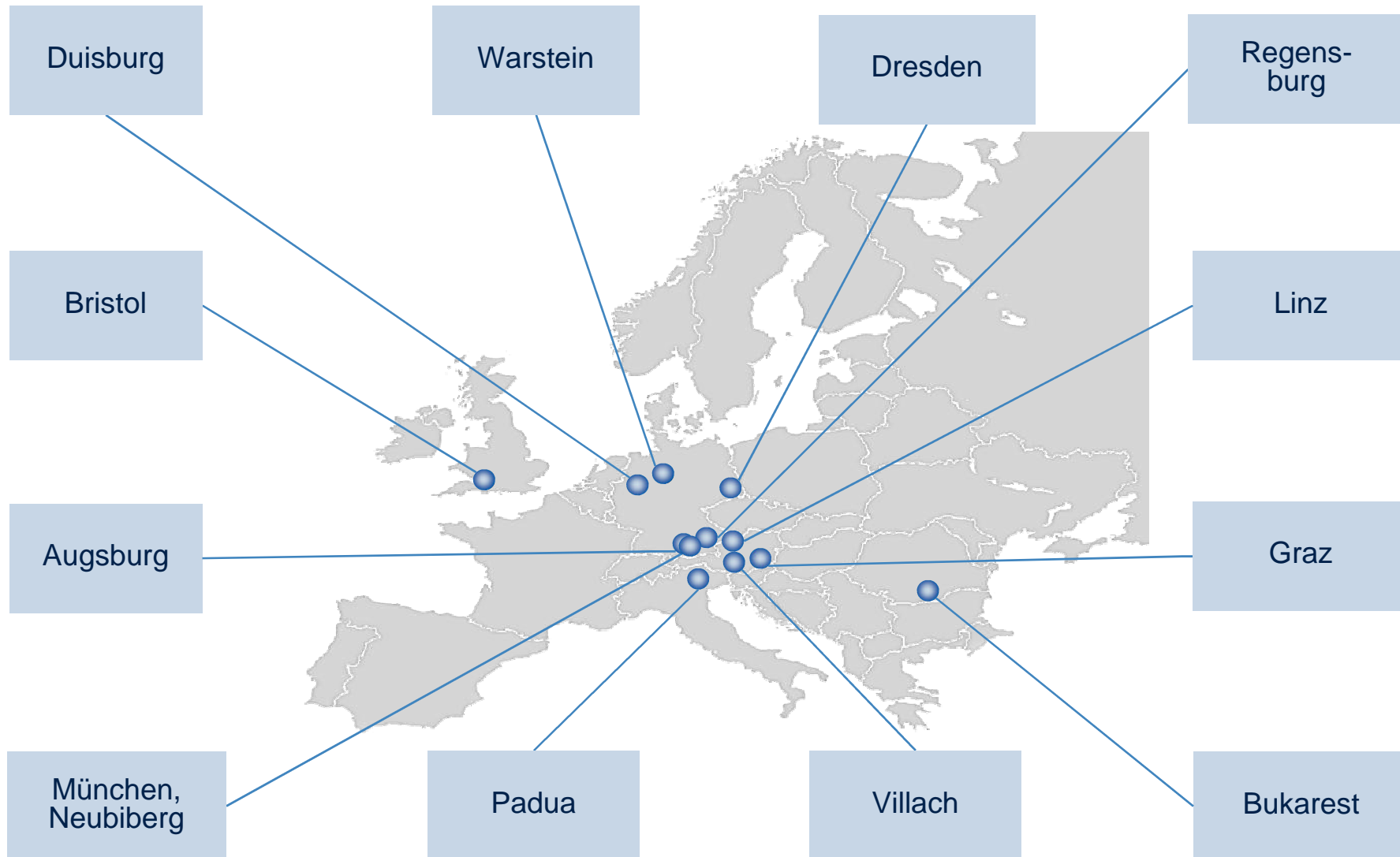
■ Divisionen, Produkte und Technologien

■ **Allgemeine Informationen zum Unternehmen**

# Infineon: 25.149 Mitarbeiter weltweit



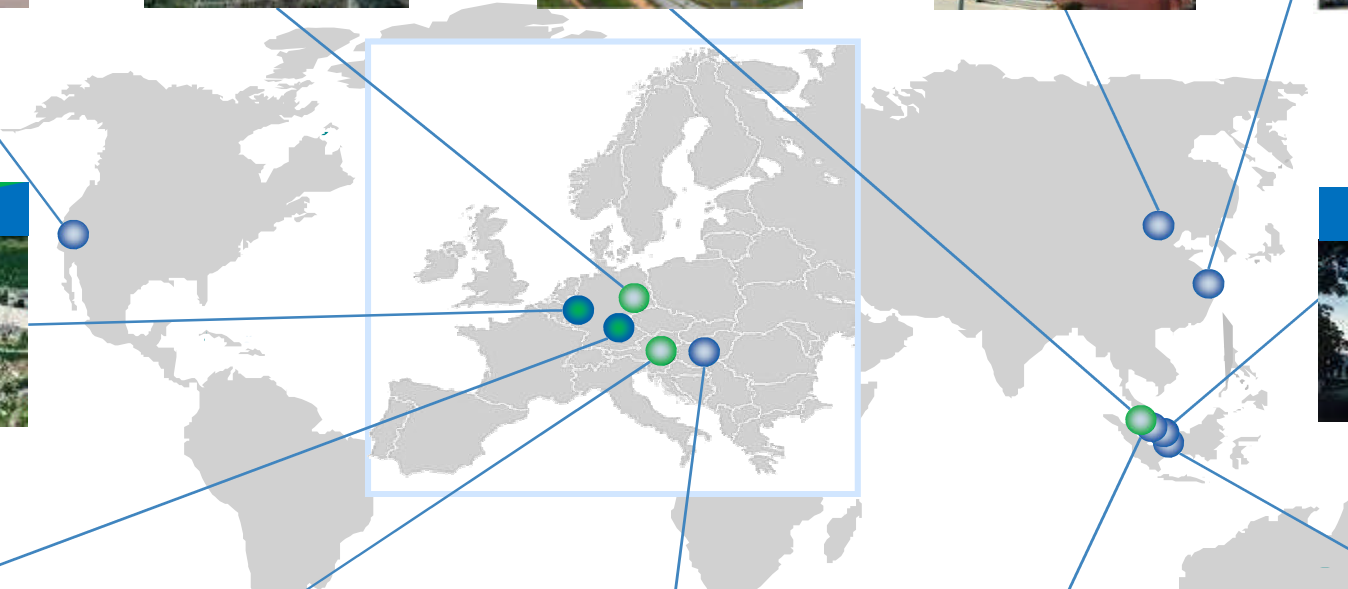
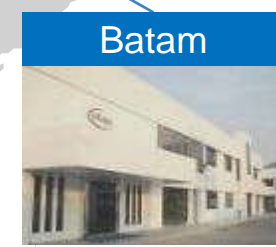
# Infineon – F&E-Standorte in Europa



# Infineon – Weltweite F&E-Standorte (ohne Europa)



# Infineon – Weltweite Fertigungsstätten Front-End- und Back-End-Fertigung



■ Front-End   ■ Back-End



# Erweiterung der 200mm-Kapazitäten in Kulim; 300mm-Thin-Wafer-Technologie in Dresden



## Kulim 2



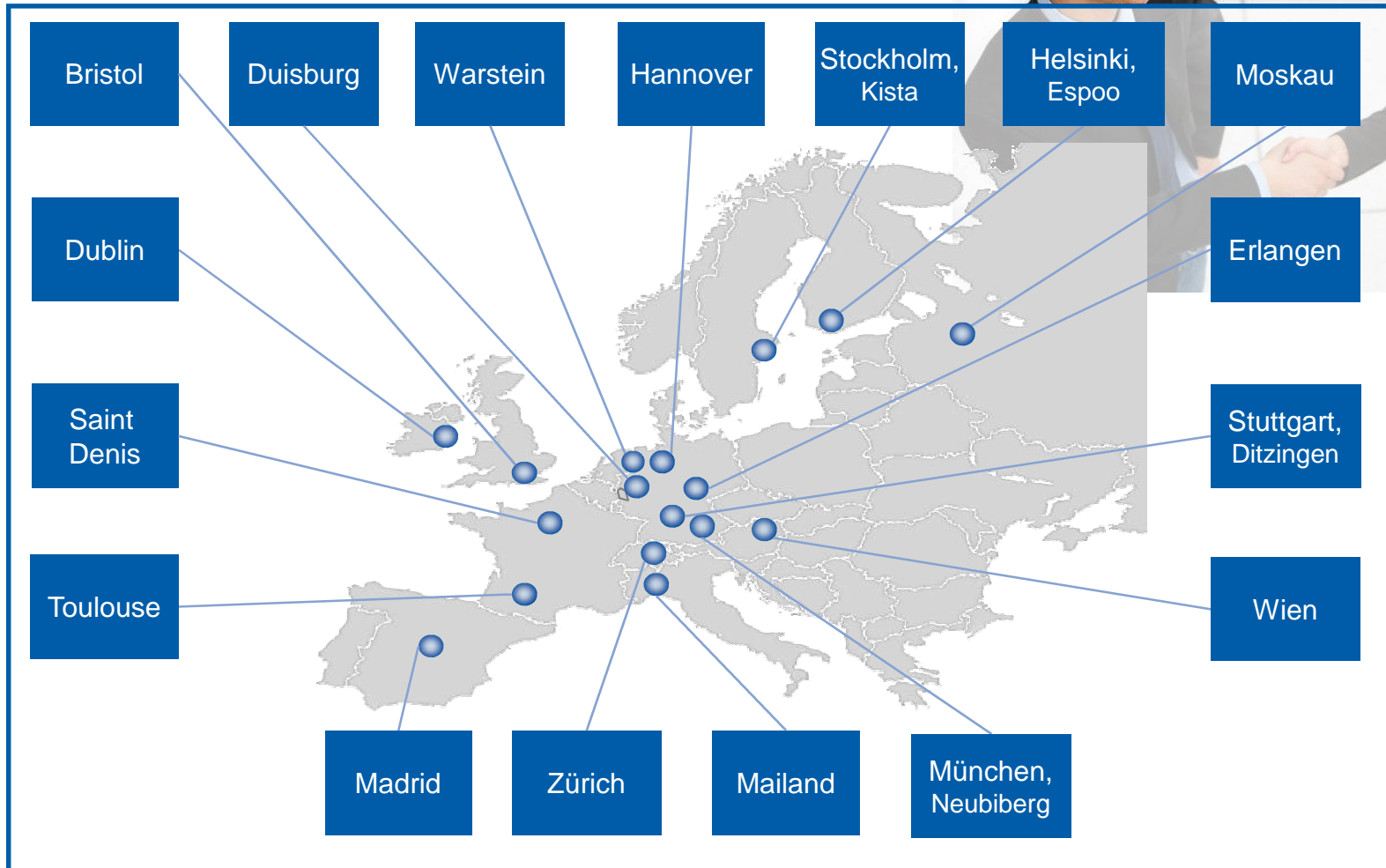
- Um das Wachstumspotential voll auszuschöpfen, wird Infineon seine kosteneffiziente 200mm-Fertigung in Kulim (Malaysia) erweitern.

## Dresden 300-mm-Technologie

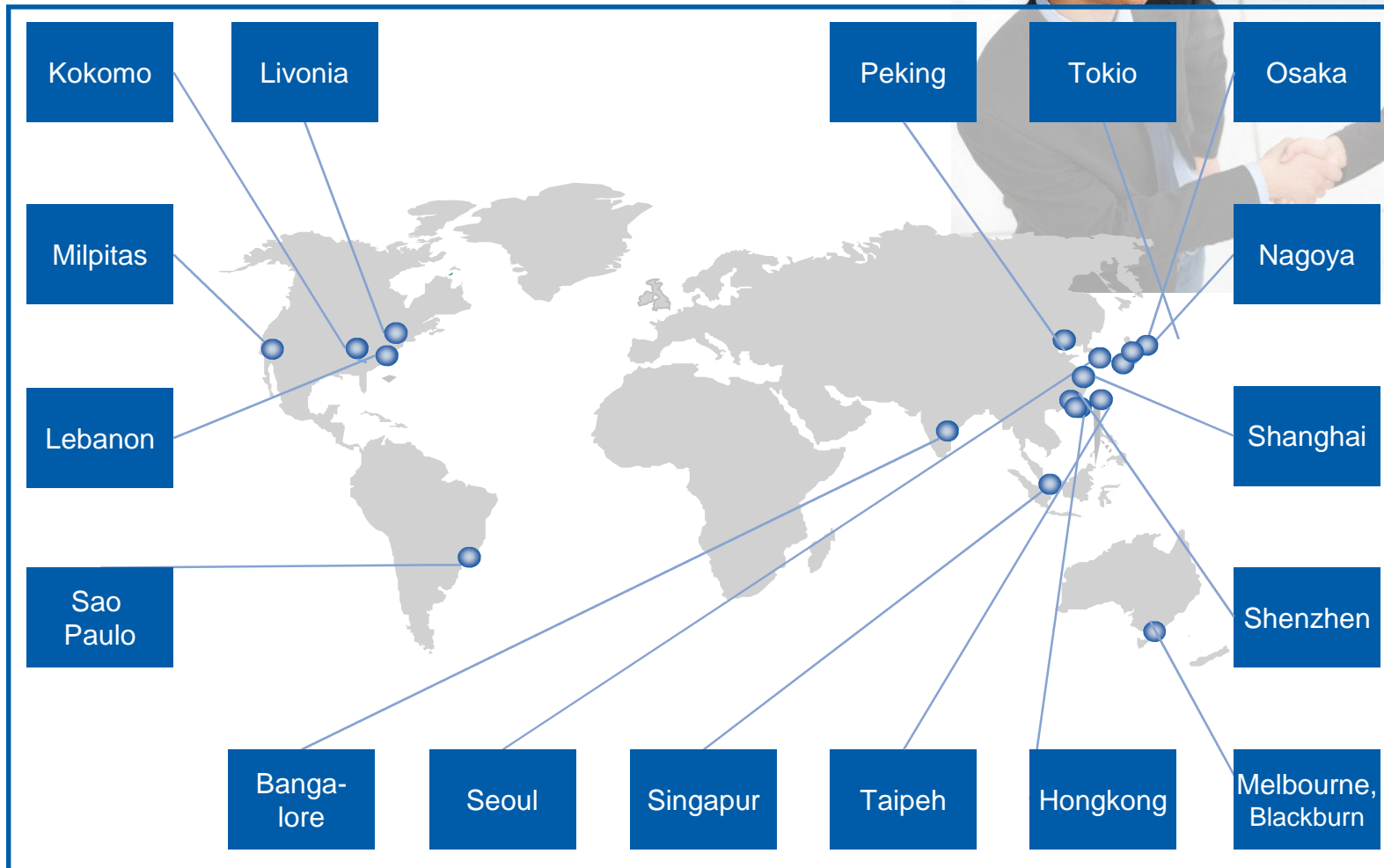


Infineon wird außerdem die neu erworbene Anlage in Dresden für die 300mm-Thin-Wafer-Fertigung von Leistungshalbleitern nutzen, um seine Position als Technologieführer in diesem Bereich weiter auszubauen.

# Infineon-Vertriebsbüros in Europa



# Infineon-Vertriebsbüros weltweit (ohne Europa)



# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt



**Zertifizierung gemäß  
ISO 14001 /  
OHSAS 18001**

**„Dow Jones  
Sustainability Indexes“  
Member 2010/11**

**Freiwillige  
Selbstverpflichtungen**

**Nachhaltigkeit  
bei Infineon**

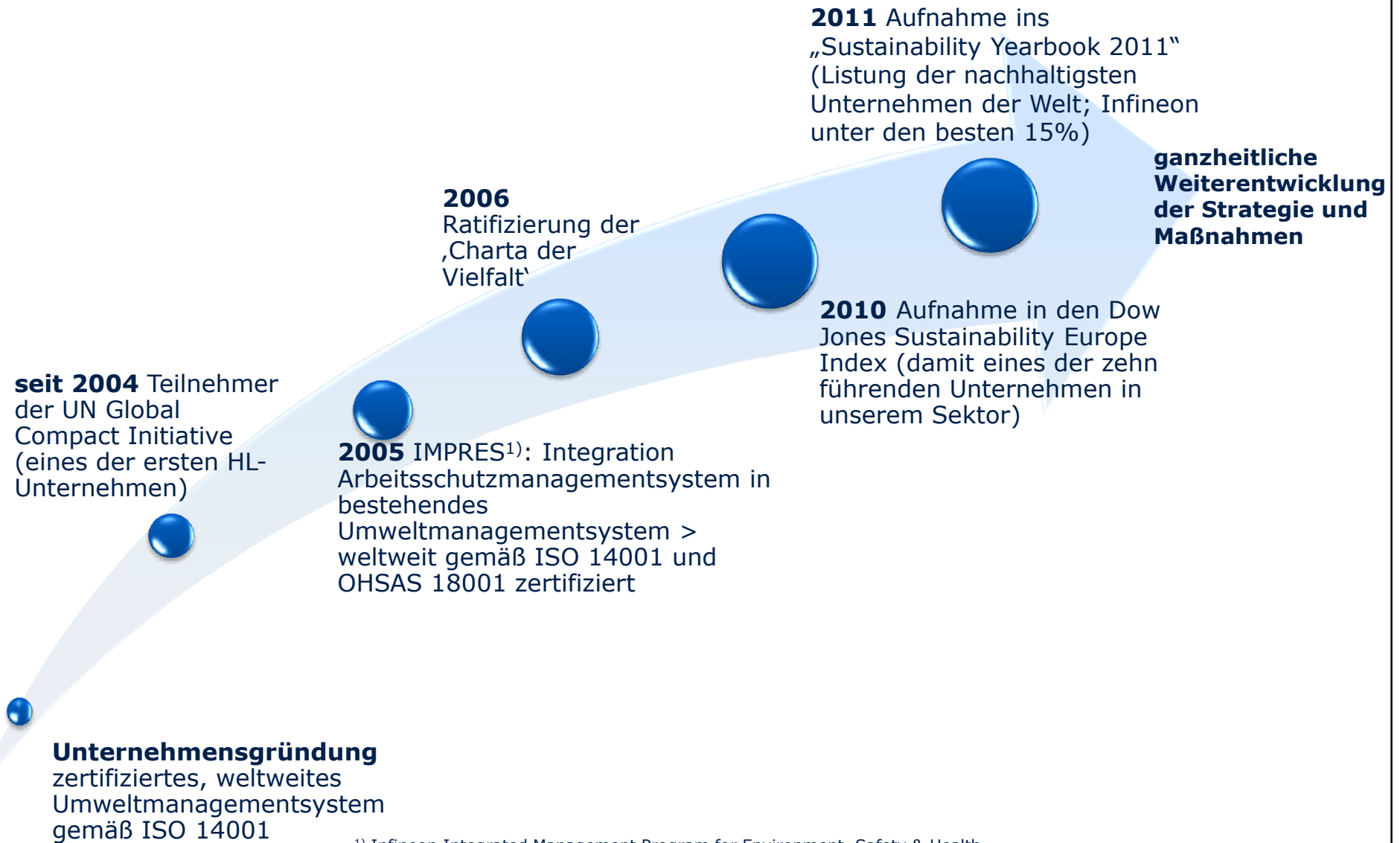
**Teilnehmer am UN  
Global Compact**

**Partnerschaften**

**Infineon unter den besten 15 % der nachhaltigsten Unternehmen weltweit\*)**

veröffentlicht im „Sustainability Yearbook 2011“; darin sind die nachhaltigsten Unternehmen weltweit aufgelistet

# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt



<sup>1)</sup> Infineon Integrated Management Program for Environment, Safety & Health

# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

## IMPRES\*): Synergie aus Verantwortung für Mensch und Umwelt sowie wirtschaftlichem Erfolg

### Matrixzertifizierung gemäß EN ISO 14001 und OHSAS 18001



**Effizientes Ressourcenmanagement im Umweltschutz**

**Hohe Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzstandards**

**Umweltinnovationen**

**Festgelegte Anforderungen entlang der Lieferkette**

**Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln bedeutet für Infineon weit mehr als nur die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben**

\*) Infineon Integrated Management Program for Environment, Safety & Health



# Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

**Wir verfügen über  
eines der  
fortschrittlichsten  
Nachhaltigkeits-  
konzepte der Welt!**

## Unsere Arbeitssicherheit

- ...verglichen mit den Zahlen der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro und Medienerzeugnisse liegt die Unfallrate bei Infineon auf einem vorbildlich niedrigen Niveau – trotz strikterer Berichtsanforderungen.

## Unsere Produkte

- ...ermöglichen energieeffiziente Endprodukte und Anwendungen.
- ...unterliegen unserer einzigartigen Lebenszyklusanalyse, um den ökologischen Fußabdruck zu optimieren.
- ...sind führend in der „green Product“ Entwicklung.

## Unsere Fertigungen

- ...ermöglichen Stromeinsparungen in der Größenordnung des Jahresverbrauchs einer Stadt mit 1,7 Mio. Einwohnern.
- ... haben dafür gesorgt, dass wir die freiwillige Selbstverpflichtung der Branche zur Reduzierung der „Kyoto-Gase“ (PFC) drei Jahre früher erreicht haben als festgelegt.
- ...setzen Maßstäbe bei der Ressourceneffizienz.

# Ganzheitliches Business Continuity Management





# ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SECURITY

Innovative semiconductor solutions for energy efficiency, mobility and security.

